

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局(43)国際公開日  
2005年11月17日(17.11.2005)

PCT

(10)国際公開番号  
WO 2005/108496 A1

- (51) 国際特許分類: C08L 83/07, 83/05
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/008490
- (22) 国際出願日: 2005年5月10日(10.05.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2004-142607 2004年5月12日(12.05.2004) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 旭電化  
工業株式会社 (ASAHI DENKA CO., LTD.) [JP/JP]; 〒  
1160012 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 Tokyo  
(JP). 関西電力株式会社 (THE KANSAI ELECTRIC  
POWER COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒5308270 大阪府  
大阪市北区中之島3丁目6番16号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: および  
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 末吉 孝
- (54) (SUEYOSHI, Takashi) [JP/JP]; 〒1160012 東京都荒  
川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式会社  
内 Tokyo (JP). 日渡 謙一郎 (HIWATARI, Ken-ichiro)  
[JP/JP]; 〒1160012 東京都荒川区東尾久7丁目2番  
35号 旭電化工業株式会社内 Tokyo (JP). 謝名堂  
正 (JANADO, Tadashi) [JP/JP]; 〒1160012 東京都荒  
川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式会社  
内 Tokyo (JP). 東海林 義和 (SHOJI, Yoshikazu)  
[JP/JP]; 〒1160012 東京都荒川区東尾久7丁目2番  
35号 旭電化工業株式会社内 Tokyo (JP). 菅原 良孝  
(SUGAWARA, Yoshitaka) [JP/JP]; 〒5308270 大阪府  
大阪市北区中之島3丁目3番2号 関西電力株式  
会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 羽鳥 修 (HATORI, Osamu), 〒1070052 東京都  
港区赤坂一丁目8番6号赤坂HKNビル6階 Tokyo  
(JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が  
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,  
(締葉有)

(54) Title: SILICON-CONTAINING CURABLE COMPOSITION AND CURED OBJECT OBTAINED BY THERMALLY CUR-  
ING THE SAME

(54) 発明の名称: ケイ素含有硬化性組成物、及びこれを熱硬化させた硬化物

(57) Abstract: A curable composition which comprises at least one of the following (A), (B), and (C) and further contains the following (D) (provided that when (C) is not contained, both (A) and (B) are contained). (A): A silicon-containing polymer in which the content of components having a weight-average molecular weight of 1,000 or lower is 20 wt.% or lower and which has a reactive group A' and one or more Si-O-Si bonds. (B): A silicon-containing polymer in which the content of components having a weight-average molecular weight of 1,000 or lower is 20 wt.% or lower and which has an Si-H group and one or more Si-O-Si bonds. (C): A silicon-containing polymer in which the content of components having a weight-average molecular weight of 1,000 or lower is 20 wt.% or lower and which has a reactive group A', an Si-H group, and one or more Si-O-Si bonds. (D): A catalyst for curing reaction which is a platinum catalyst. The reactive group A' is any of Si-R<sup>1</sup>, Si-O-R<sup>2</sup>, and Si-R<sup>3</sup>-OCOC(R<sup>4</sup>)=CH<sub>2</sub>, provided that R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> each is alkenyl, R<sup>3</sup> is alkylene and/or arylene, and R<sup>4</sup> is hydrogen or methyl.

(57) 要約:

下記(A), (B), (C)の何れか一つ以上と(D)とを含む硬化性組成物。

(ただし(C)を含有しない場合は(A), (B)両方を含む)

- (A) : 反応基A'を有し、Si—O—Si結合を一つ以上有する、  
重量平均分子量1000以下の成分が20重量%以下のケイ素含有重合体
- (B) : Si—H基を有し、Si—O—Si結合を一つ以上有する、  
重量平均分子量1000以下の成分が20重量%以下のケイ素含有重合体
- (C) : 反応基A'、とSi—H基を有し、Si—O—Si結合を一つ以上有する、  
重量平均分子量1000以下の成分が20重量%以下のケイ素含有重合体
- (D) : 白金系触媒である硬化反応触媒
- 反応基A'とは、Si—R<sup>1</sup>、Si—O—R<sup>2</sup>、Si—R<sup>3</sup>—OCOC(R<sup>4</sup>)=CH<sub>2</sub>、  
の何れかであり、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>はアルケニル基、R<sup>3</sup>はアルキレン基及び/又はアリ  
ーレン基、R<sup>4</sup>は水素又はメチル基である。

WO 2005/108496 A1



BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,  
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,  
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,  
NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,  
SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,  
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護  
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,  
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,  
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,

BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,  
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),  
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 國際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイドスノート」を参照。